

半導体パッケージ周辺用の放熱材料の開発

日夏 雅子*, 藤原 武*

Development of Novel Heat Dissipation Materials Applying to Semiconductor Packages

Masako HINATSU* and Takeshi FUJIWARA*

* JNC 石油化学株式会社市原研究所研究第3センター34グループ (〒290-8511 千葉県市原市五井海岸 5-1)

* JNC PETROCHEMICAL CORPORATION ICHIHARA RESERCH CENTER Research Laboratory III (5-1, Goikaigan, Ichihara, Chiba 290-8551)